

ALPHA

PAL60 Installation Guide

Dec,2001

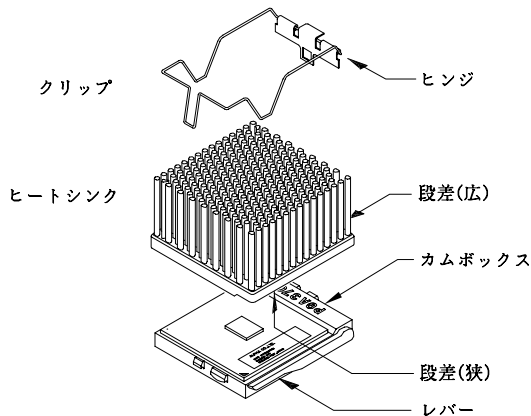
X001ZF0K-02

梱包の中に次の物が同梱されているか、ご確認ください。

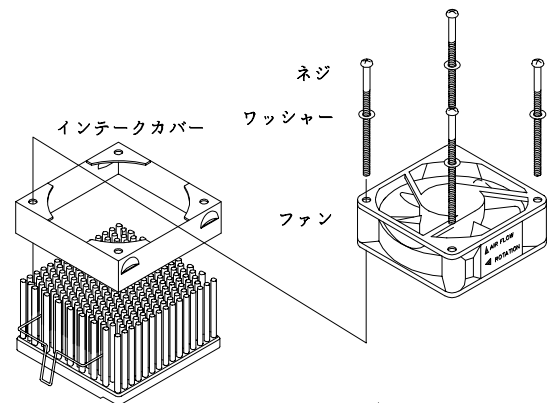
PARTS	QTY	MODEL		
		PAL6035 , PAL6030		
		AC	MFC	MUC
ヒートシンク	1	○	○	○
インテークカバー	1		○	○
クリップ CL57G	1	○	○	○
ネジ (ファン取付用)	4		○	○
ワッシャー (ファン取付用)	4		○	○
ファン (60mm角ファン)	1			○
サーマルグリス YG6260-5	1			○
パッド	1	○	○	○

STEP 1 ヒートシンクユニット組立て前に他部品やソケットのレバー等との干渉が無いか確認してください。
ヒートシンク裏面の狭い段差側がソケットのレバー側、広い段差がソケットのカムボックス側になります。

注意：クリップはソケットに対し必ず下図に示す方向に組み込んで下さい。ヒンジ(金具)側がソケットのカムボックス側になります。



STEP 2 ヒートシンクにクリップを差し込んだ状態で、インテークカバーをヒートシンク上面にセットします。
(インテークカバーの白いシートは加工時の傷防止用のシートですので組付け前に取除いてください。)
次にファンを載せ、ワッシャーを入れたネジをヒートシンクのベース面迄通して組付けてください。

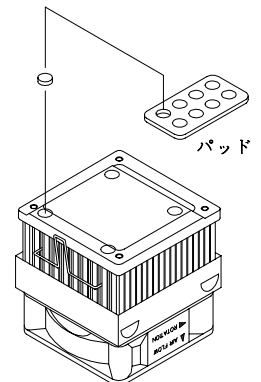
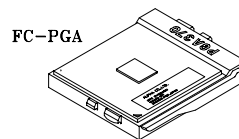


STEP 3 ベース面には防錆油が塗布されています。
次項に示すとうり、FC-PGA に使用する場合はパッドを貼り付けますのできれいな布等で油分を取り除いて下さい。

STEP 4

- FC-PGA に使用する場合
ヒートシンク裏面 4 箇所の丸いマークの位置にパッドを貼り付けて下さい。(右図参照)
残ったパッドはスペアとして保管して下さい。

- PPGA , Athlon , Duron に使用する場合
パッドを貼り付ける必要はありません。



STEP 5 ヒートシンクとCPUの接触面 おおのにサーマルグリスを薄く均一に塗布して下さい。
サーマルグリスの量が多いと性能低下につながりますので注意して下さい。
ボードへのダメージを避ける為、過度に荷重をかけないでください。過度の荷重は設置ミスの原因にもなります。
クリップはソケットタブの正しい位置に引っ掛けてください。

STEP 5 最終確認
ヒートシンクがCPUと傾くことなく設置されているか (ソケットのカムボックスやレバー及び他のコンポーネント等に接触せず、CPUだけに正しく接触していることを) 目視で確認して下さい。

information subject to change without notice.